



Electronics for the Future

# 決算発表 補足資料

## 2024年度 第4四半期業績

2025年5月14日  
ローム株式会社  
広報IR部

# 2024年度 第4四半期 実績 業績報告 (前年同期比)



(単位：億円)

	FY2024 第4四半期 実績	FY2023 第4四半期 実績	増減額	増減率
売上高	<b>1,038</b>	<b>1,126</b>	<b>▲88</b>	<b>▲7.8%</b>
営業利益	<b>▲289</b>	<b>26</b>	<b>▲315</b>	<b>-</b>
(対売上比率)	<b>(▲27.9%)</b>	<b>(2.4%)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
経常利益	<b>▲300</b>	<b>90</b>	<b>▲390</b>	<b>-</b>
(対売上比率)	<b>(▲28.9%)</b>	<b>(8.1%)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
純利益	<b>▲502</b>	<b>88</b>	<b>▲590</b>	<b>-</b>
(対売上比率)	<b>(▲48.4%)</b>	<b>(7.9%)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
EBITDA	<b>▲70</b>	<b>238</b>	<b>▲308</b>	<b>-</b>
(対売上比率)	<b>(▲6.8%)</b>	<b>(21.2%)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

期中平均レート(¥/US\$) (152.95円) (147.87円)

期末レート(¥/US\$) (149.52円) (151.41円)

(単位：億円)

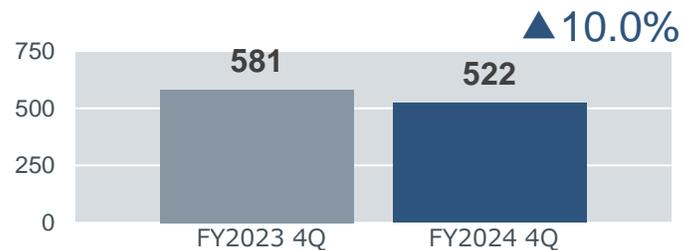
## 四半期売上高

**1,126億円** ▲7.8%  
**1,038億円**

FY2023 第4四半期  
実績

FY2024 第4四半期  
実績

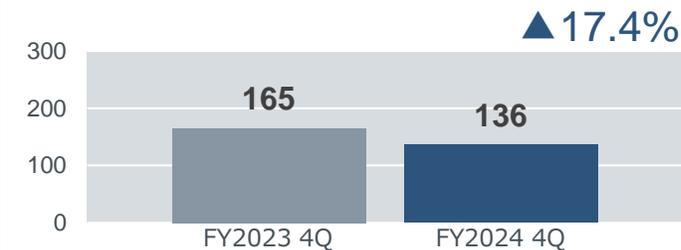
## 自動車



- インフォテインメント分野 ▲10
- ボディ分野 ▲7
- パワートレイン分野 +3
- 安全走行ADAS分野 ▲1
- xEV分野 ▲43
- その他 +0



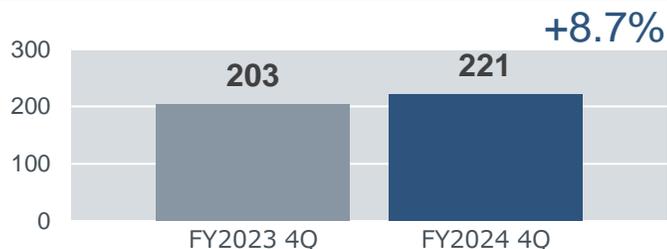
## 産機



- FA分野 ▲4
- エネルギー分野 ▲10
- ホームビルディング分野 ▲3
- その他 ▲12



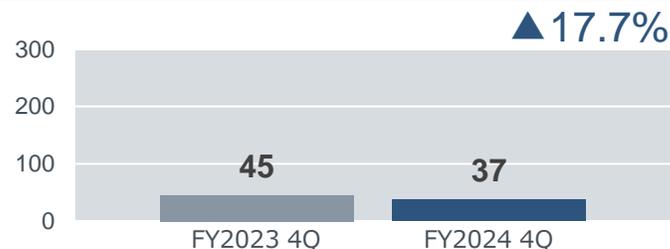
## 民生



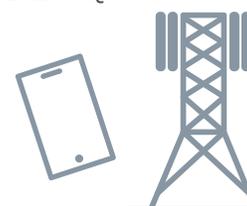
- AV関連 +1
- 家電分野 ▲2
- その他 +18



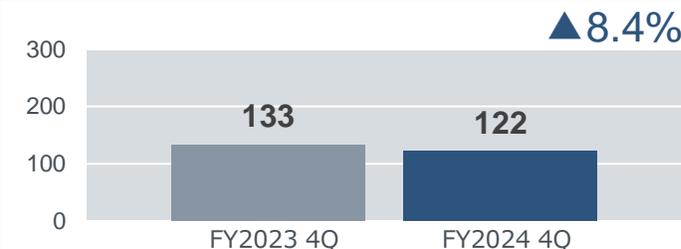
## 通信



- スマホ&モバイル分野 ▲5
- 基地局&インフラ分野 ▲2
- 有線通信分野 ▲1



## コンピュータ & ストレージ



- PC&サーバー分野 ▲9
- 決済端末向け ▲2
- 事務機分野 +0



# 2024年度 第4四半期 国籍別 売上の変動要因 (前年同期比)

四半期売上高

1,126億円

1,038億円

FY2023 第4四半期実績

FY2024 第4四半期実績

▲7.8%

海外売上高比率

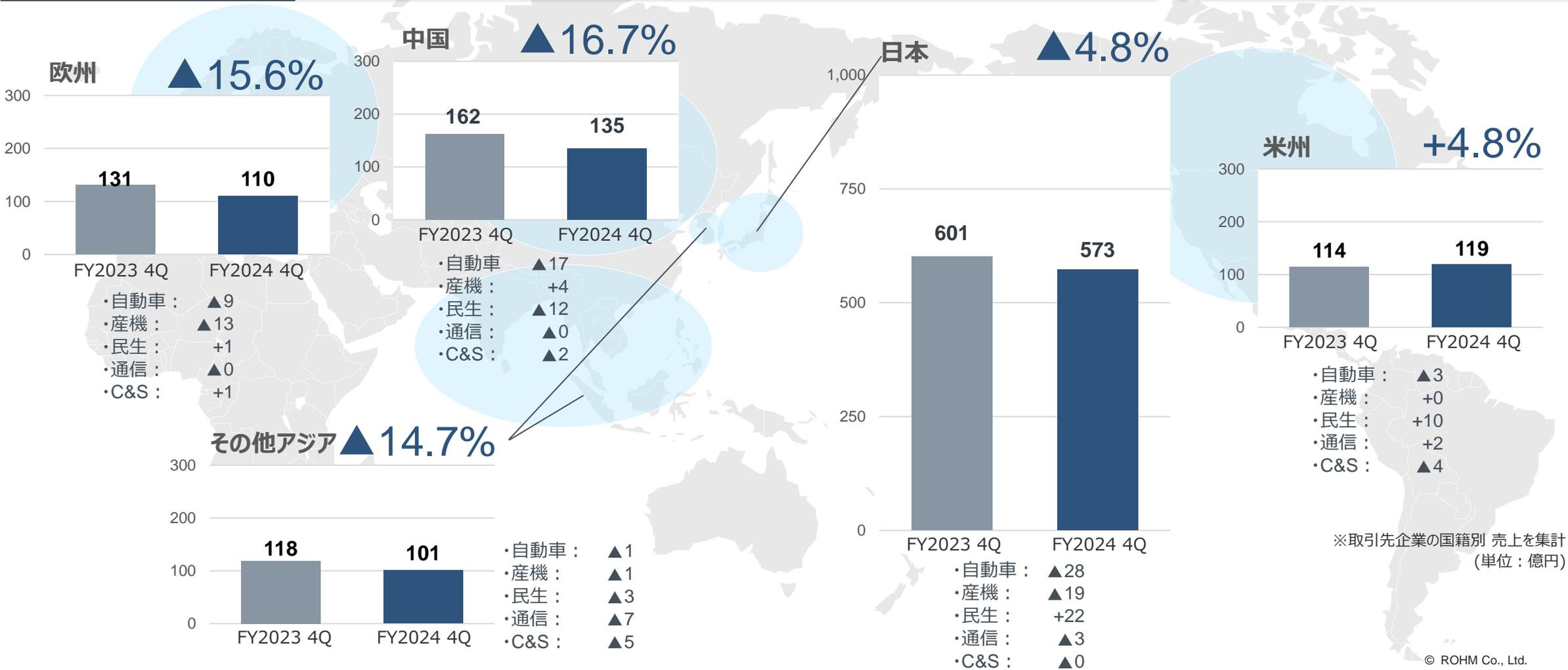
46.6%

FY2023 第4四半期

44.8%

FY2024 第4四半期

第4四半期 前年同期比

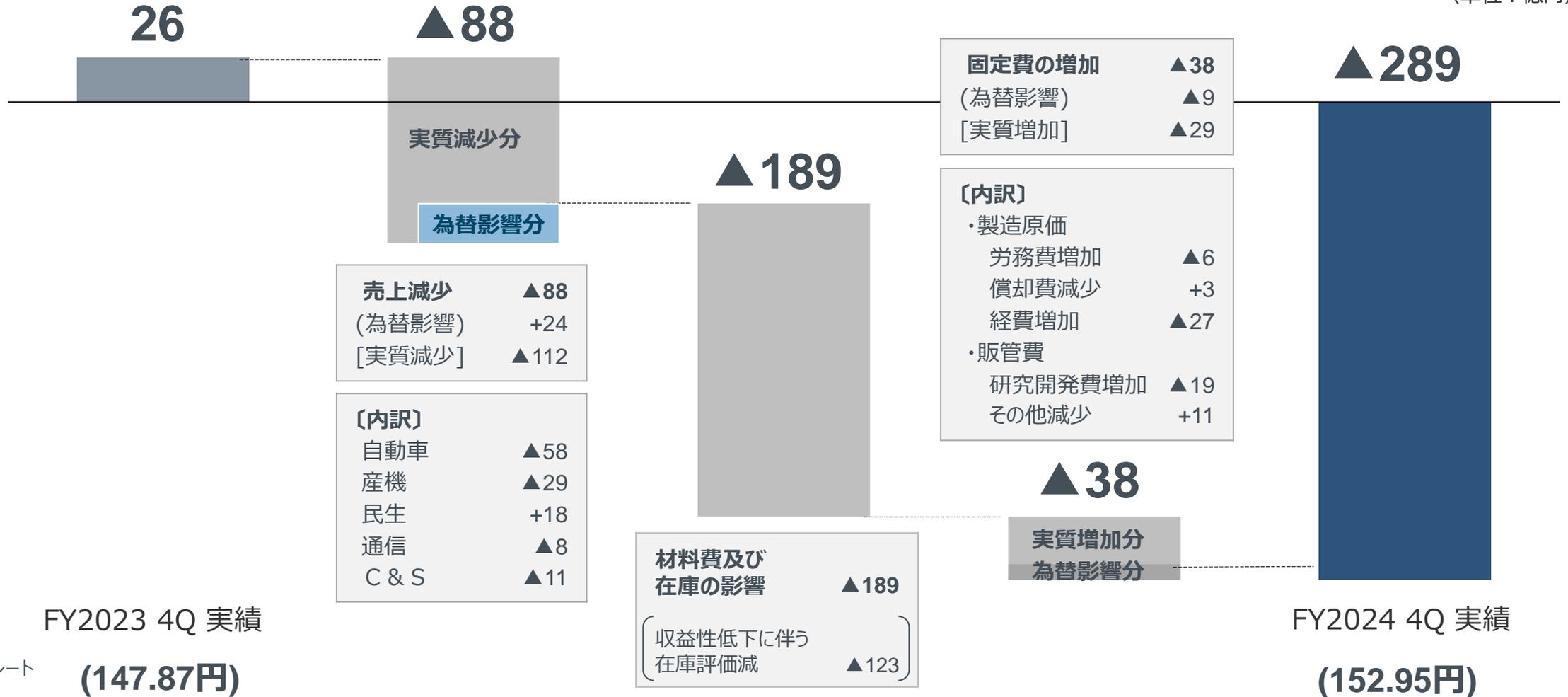


※取引先企業の国籍別 売上を集計 (単位: 億円)

# 2024年度 第4四半期 営業利益 増減分析 (前年同期比)

**315億円減益**

(単位：億円)



FY2023 4Q 実績

**(147.87円)**

期中平均レート  
(¥/US\$)

FY2024 4Q 実績

**(152.95円)**

# 2024年度 第4四半期 セグメント別 (前年同期比)

(単位：億円)

		FY2024 第4四半期 実績	FY2023 第4四半期 実績	増減額	増減率
LSI	売上	479	486	▲7	▲1.5%
	セグメント利益	▲47	34	▲81	-
	(利益率)	( ▲9.9%)	( 7.0%)	-	-
半導体素子	売上	429	503	▲74	▲14.7%
	セグメント利益	▲254	▲15	▲238	-
	(利益率)	( ▲59.2%)	( ▲3.1%)	-	-
モジュール	売上	68	73	▲4	▲6.0%
	セグメント利益	▲0	▲0	+0	-
	(利益率)	( ▲0.3%)	( ▲1.2%)	-	-
その他	売上	60	63	▲3	▲4.1%
	セグメント利益	6	4	+2	+33.5%
	(利益率)	( 10.4%)	( 7.5%)	-	-

# 2024年度 第4四半期 実績 業績報告 (直前四半期比)

(単位：億円)

	FY2024 第4四半期 実績	FY2024 第3四半期 実績	増減額	増減率
売上高	<b>1,038</b>	<b>1,126</b>	<b>▲88</b>	<b>▲7.8%</b>
営業利益	<b>▲289</b>	<b>▲101</b>	<b>▲188</b>	-
(対売上比率)	<b>(▲27.9%)</b>	<b>(▲9.0%)</b>	-	-
経常利益	<b>▲300</b>	<b>4</b>	<b>▲304</b>	-
(対売上比率)	<b>(▲28.9%)</b>	<b>(0.4%)</b>	-	-
純利益	<b>▲502</b>	<b>▲18</b>	<b>▲484</b>	-
(対売上比率)	<b>(▲48.4%)</b>	<b>(▲1.6%)</b>	-	-
EBITDA	<b>▲70</b>	<b>110</b>	<b>▲180</b>	-
(対売上比率)	<b>(▲6.8%)</b>	<b>(9.9%)</b>	-	-

期中平均レート(¥/US\$) (152.95円) (151.32円)

期末レート(¥/US\$) (149.52円) (158.18円)

(単位：億円)

## 四半期売上高

1,126億円

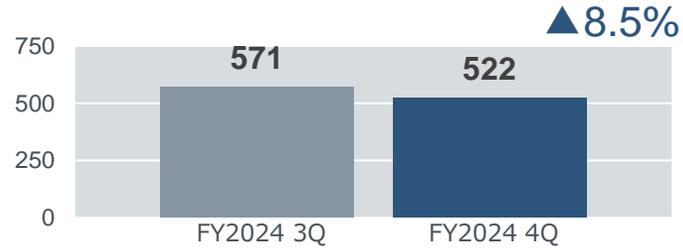
FY2024 第3四半期  
実績

1,038億円

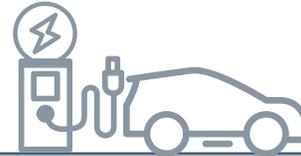
FY2024 第4四半期  
実績

▲7.8%

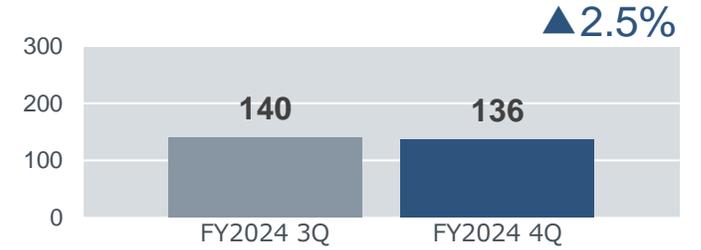
## 自動車



- インフォテインメント分野 ▲12
- ボディ分野 ▲1
- パワートレイン分野 ▲3
- 安全走行ADAS分野 ▲6
- xEV分野 ▲24
- その他 ▲3



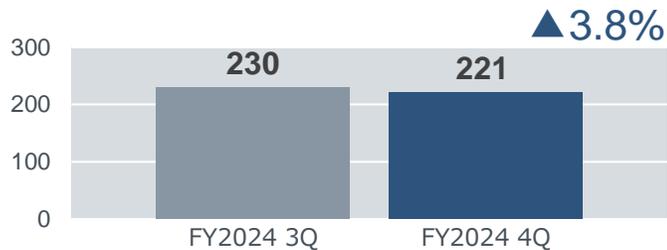
## 産機



- FA分野 +1
- エネルギー分野 ▲0
- ホームビルディング分野 ▲3
- その他 ▲2



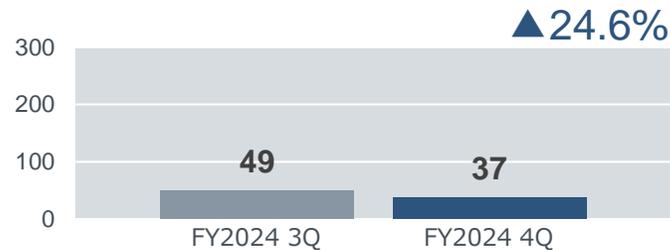
## 民生



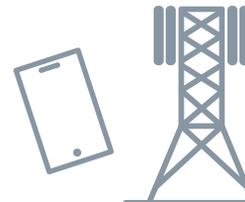
- AV関連 +0
- 家電分野 ▲6
- その他 ▲3



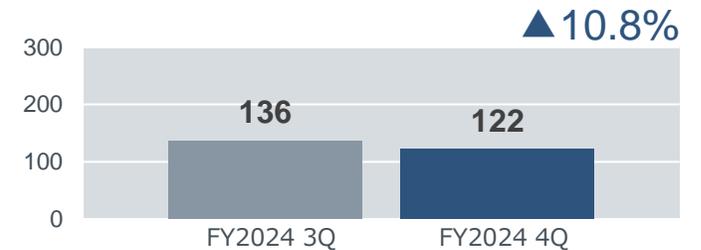
## 通信



- スマホ&モバイル分野 ▲12
- 基地局&インフラ分野 +0
- 有線通信分野 ▲0



## コンピュータ & ストレージ



- PC&サーバー分野 ▲8
- 決済端末向け ▲5
- 事務機分野 ▲2



# 2024年度 第4四半期 国籍別 売上の変動要因 (直前四半期比)

四半期売上高

1,126億円

1,038億円

FY2024 第3四半期実績

FY2024 第4四半期実績

▲7.8%

海外売上高比率

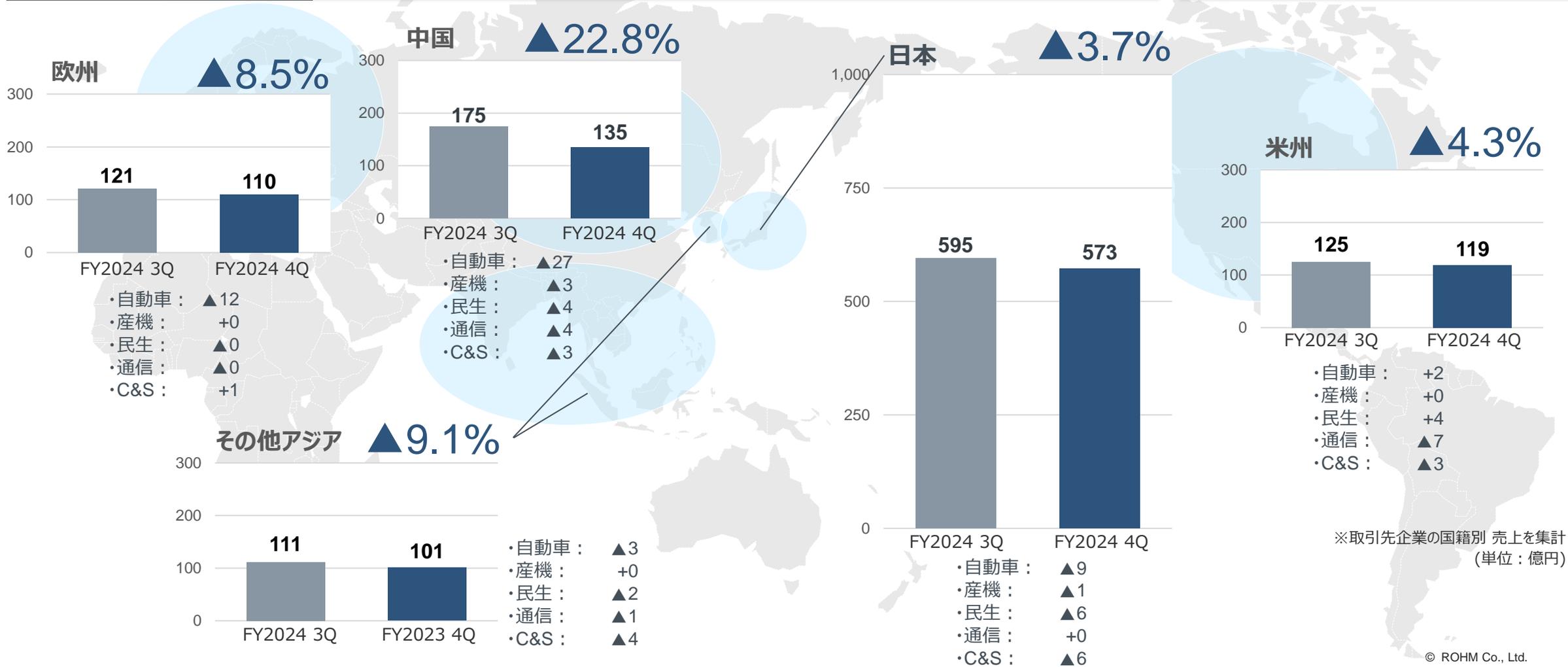
47.2%

FY2024 第3四半期

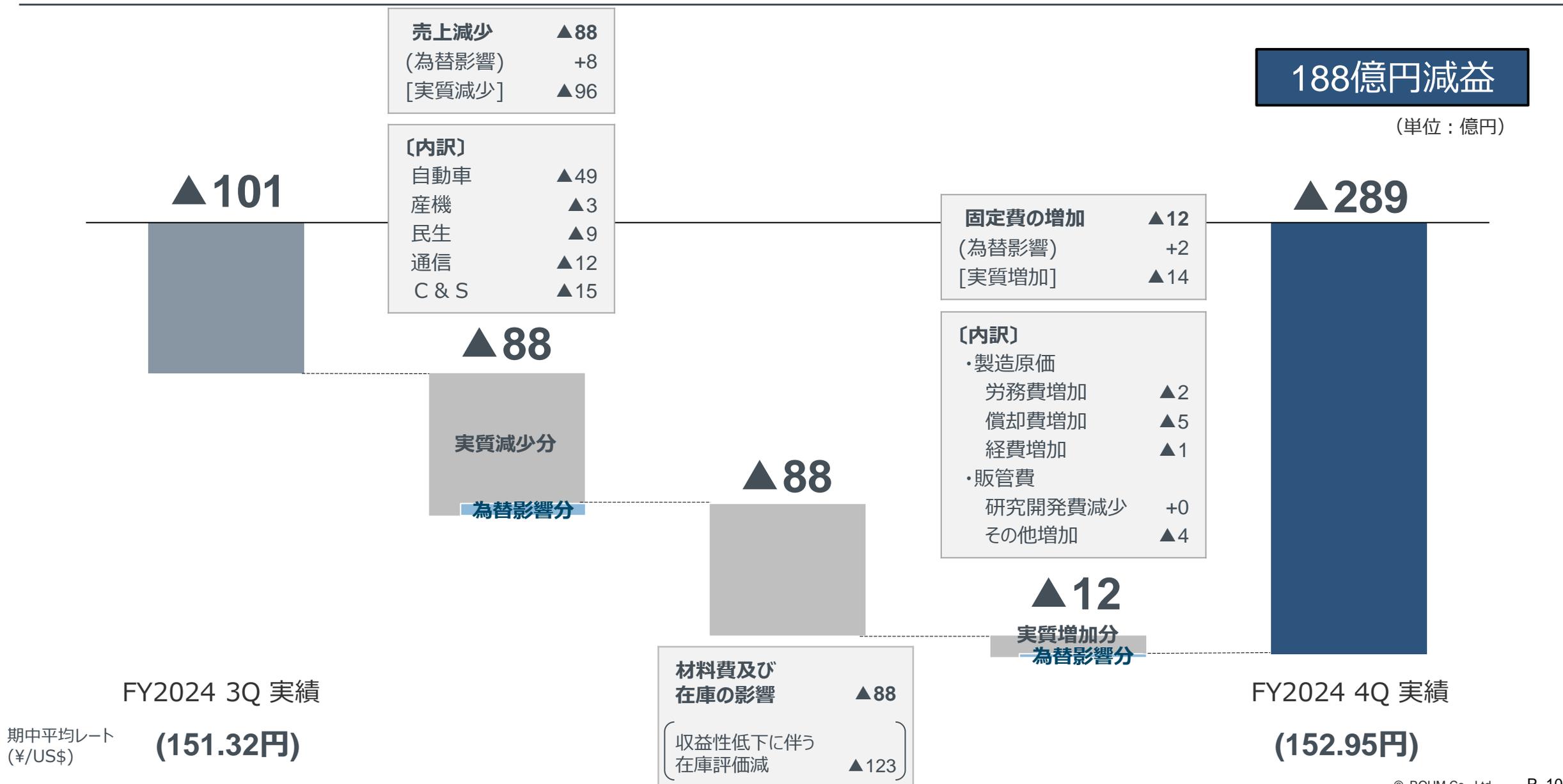
44.8%

FY2024 第4四半期

第4四半期 直前四半期比



# 2024年度 第4四半期 営業利益 増減分析 (直前四半期比)



# 2024年度 第4四半期 セグメント別 (直前四半期比)

(単位：億円)

		FY2024 第4四半期 実績	FY2024 第3四半期 実績	増減額	増減率
LSI	売上	479	516	▲37	▲7.2%
	セグメント利益	▲47	▲15	▲32	-
	(利益率)	( ▲9.9%)	( ▲3.0%)	-	-
半導体素子	売上	429	468	▲39	▲8.4%
	セグメント利益	▲254	▲100	▲154	-
	(利益率)	( ▲59.2%)	( ▲21.5%)	-	-
モジュール	売上	68	79	▲11	▲13.1%
	セグメント利益	▲0	5	▲5	-
	(利益率)	( ▲0.3%)	( 7.1%)	-	-
その他	売上	60	61	▲1	▲1.7%
	セグメント利益	6	3	+3	+74.8%
	(利益率)	( 10.4%)	( 5.9%)	-	-

- [2025-02-13 ロームのEcoGaN™が、村田製作所グループであるMurata Power Solutions のAIサーバー向け電源に採用](#)
- [2025-02-17 4月1日以降の役員体制について](#)
- [2025-02-26 AIサーバー等の高性能サーバー向け、業界トップクラスの低オン抵抗・高耐量MOSFETを開発](#)
- [2025-03-13 業界トップクラスの放射強度！小型・面実装 近赤外LEDを開発](#)
- [2025-03-18 AI機能搭載マイコンを開発](#)
- [2025-03-25 負電圧・高電圧（40V/80V）対応！ 高精度 電流センスアンプ](#)
- [2025-03-27 マツダとローム、次世代半導体を用いた自動車部品の共同開発を開始](#)
- [2025-04-15 業界トップの低オン抵抗！急速充電に最適な小型MOSFETを開発](#)
- [2025-04-24 OBCのデファクトスタンダードへ！高電力密度の新型SiCモジュールを開発](#)
- [2025-05-08 デンソーとローム、半導体分野における戦略的パートナーシップ構築に向けて基本合意](#)
- [2025-05-12 ロームの最新2kV SiC MOSFETを搭載したセмикロンドランフォスのモジュールが、SMAの太陽光システムに採用](#)



Electronics for the Future